

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆利斌
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司及境外全资孙公司拟向银行新增综合授信额度暨为境外全资孙公司提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

因同享(苏州)电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务规模扩张迅速，以及境外全资孙公司同享电子材料科技马来西亚私人有限公司（Tonyshare Electronic

Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.) (以下简称“境外全资孙公司”)海外业务的开展,为满足公司及境外全资孙公司日常营运资金的需求,拟向上海银行股份有限公司苏州分行新增申请合计不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元人民币或等值美元)的综合授信额度,其中公司授信额度 5,000 万元、境外全资孙公司授信额度 3,000 万元,同时由公司为境外全资孙公司该笔 3,000 万元授信提供连带责任担保,公司及境外全资孙公司可根据实际资金需求在授信额度内循环使用,授信有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。拟向银行申请的授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额与融资利率以与银行签订的融资合同为准。在授信有效期内,董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理公司的融资事宜,并签署有关业务往来的法律文件。具体授信业务品种、额度、期限和利率,以公司与银行签署的合同为准。此次授信由公司为境外全资孙公司的上述授信业务提供连带责任担保。

具体内容请详见公司 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的公告《关于公司及境外全资孙公司拟向银行新增综合授信额度暨为境外全资孙公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-050)

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日